



# 平成25年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成24年9月28日

上場取引所 東

上場会社名 三益半導体工業株式会社

コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長

(氏名) 中澤 正幸

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長

(氏名) 八高 達郎

TEL 027-372-2011

四半期報告書提出予定日 平成24年10月15日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成25年5月期第1四半期の業績(平成24年6月1日～平成24年8月31日)

### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年5月期第1四半期	12,370	13.8	697	△41.2	667	△40.2	403	△36.9
24年5月期第1四半期	10,868	△34.5	1,187	50.8	1,115	96.2	639	99.4

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年5月期第1四半期	12.06	—
24年5月期第1四半期	19.11	—

### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年5月期第1四半期	67,930	51,906	76.4
24年5月期	65,089	51,893	79.7

(参考) 自己資本 25年5月期第1四半期 51,906百万円 24年5月期 51,893百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00
25年5月期	—				
25年5月期(予想)		12.00	—	12.00	24.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

## 3. 平成25年5月期の業績予想(平成24年6月1日～平成25年5月31日)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	22,000	△5.8	1,100	△32.7	1,050	△30.2	600	△29.8	17.92

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

平成25年5月期(通期)の業績予想につきましては、現時点で適切な予想値を算定することが困難であるため、未定といたしました。なお、当該理由等は、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3)業績予想に関する定性的情報」に記載しております。

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

25年5月期1Q	35,497,183 株	24年5月期	35,497,183 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

25年5月期1Q	2,015,131 株	24年5月期	2,015,059 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年5月期1Q	33,482,100 株	24年5月期1Q	33,482,437 株
----------	--------------	----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 業績予想に関する定性的情報 .....	2
2. 四半期財務諸表 .....	4
(1) 四半期貸借対照表 .....	4
(2) 四半期損益計算書 .....	6
(3) 継続企業の前提に関する注記 .....	7
(4) セグメント情報 .....	7
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	7

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景として緩やかに持ち直してきたものの、円高の長期化や世界的な景気減速などの影響により、依然として厳しい状況が続きました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、スマートフォン（高機能携帯電話）やタブレット端末の需要は堅調でありましたが、パソコンや薄型テレビなど民生用電子機器の需要が低調に推移したことから、厳しい状況が続きました。

このような経営環境の中で当社は、経営全般にわたる徹底した合理化や効率化の推進、省電力対策の実施など、総力を挙げて業績の改善に取り組みました。

この結果、当第1四半期累計期間の売上高は123億7千万円と前年同四半期比13.8%の増収となり、営業利益は6億9千7百万円（前年同四半期比41.2%減）、経常利益は6億6千7百万円（同40.2%減）、四半期純利益は4億3百万円（同36.9%減）となりました。

#### 半導体事業部

当事業部におきましては、全体的には厳しい状況が続いたものの、一部の生産は堅調に推移いたしました。そうした中で、引き続き更なる生産性の向上と徹底した合理化を推進いたしました。

#### 産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、その他の取扱商品において大幅な増収となりました。

#### エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

### (2) 財政状態に関する定性的情報

当第1四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前事業年度末と比較して28億4千1百万円増加し、679億3千万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により28億2千8百万円増加し、160億2千4百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加2百万円等により、519億6百万円となりました。

### (3) 業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、円高の長期化やデフレの影響などが懸念され、わが国経済は予断を許さない状況が続くものと予想されます。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、半導体デバイス需要の動向をはじめとして、先行き不透明な事業環境が見込まれております。

このような経営環境のもと、当社といたしましては今後も徹底した合理化による低コスト生産体制の構築に取り組むとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努めてまいります。

未定としておりました平成25年5月期第2四半期累計期間の業績予想及び配当予想につきましては、本日、別途「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」にて開示いたしております。第2四半期累計期間の業績は、売上高220億円、営業利益11億円、経常利益10億5千万円、当期純利益6億円を見込んでおります。

通期の業績予想につきましては、半導体デバイスの需要動向などが流動的な状況にあり、先行きの事業

環境が見通せないことから、現時点においても適切な予想値を算定することが困難であるため、未定とさせていただきます。なお、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。

また、配当金につきましては、当社は業績の向上と株主の皆様への利益配分をともに経営の重要課題と位置付けており、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本方針としております。このような方針のもと、中間、期末ともに前期と同額の1株当たり12円を予定しております。これにより、年間の配当予想は前期と同様1株当たり24円となります。

2. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成24年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	17,184	17,435
受取手形及び売掛金	14,490	18,018
商品及び製品	181	153
仕掛品	611	309
原材料及び貯蔵品	926	912
その他	2,103	2,174
貸倒引当金	△16	△19
流動資産合計	35,481	38,985
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	14,069	13,771
その他(純額)	12,584	12,316
有形固定資産合計	26,653	26,087
無形固定資産	1,283	1,208
投資その他の資産		
その他	1,678	1,656
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	1,671	1,649
固定資産合計	29,608	28,945
資産合計	65,089	67,930
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,642	12,684
短期借入金	100	100
引当金	58	384
その他	1,599	1,077
流動負債合計	11,400	14,246
固定負債		
長期借入金	250	250
退職給付引当金	1,358	1,343
その他	187	183
固定負債合計	1,796	1,777
負債合計	13,196	16,024

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成24年5月31日)	当第1四半期会計期間 (平成24年8月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	17,699	17,701
自己株式	△3,409	△3,409
株主資本合計	51,891	51,893
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1	12
評価・換算差額等合計	1	12
純資産合計	51,893	51,906
負債純資産合計	65,089	67,930

(2) 四半期損益計算書  
(第1四半期累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期累計期間 (自平成23年6月1日 至平成23年8月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成24年6月1日 至平成24年8月31日)
売上高	10,868	12,370
売上原価	9,010	11,114
売上総利益	1,857	1,255
販売費及び一般管理費	670	557
営業利益	1,187	697
営業外収益		
受取利息	1	2
受取配当金	1	2
その他	7	5
営業外収益合計	11	10
営業外費用		
支払利息	0	0
為替差損	35	11
設備休止費用	42	28
その他	4	0
営業外費用合計	82	40
経常利益	1,115	667
特別利益		
固定資産売却益	0	—
特別利益合計	0	—
特別損失		
固定資産売却損	—	0
固定資産除却損	22	0
特別損失合計	22	0
税引前四半期純利益	1,094	666
法人税、住民税及び事業税	165	69
法人税等調整額	288	193
法人税等合計	454	262
四半期純利益	639	403

## (3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (4) セグメント情報

報告セグメントごとの売上高に関する情報

前第1四半期累計期間(自平成23年6月1日至平成23年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	7,660	3,207	—	10,868	—	10,868
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	—	314	316	△316	—
合計	7,662	3,207	314	11,814	△316	10,868

当第1四半期累計期間(自平成24年6月1日至平成24年8月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	5,487	6,882	—	12,370	—	12,370
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	—	632	632	△632	—
合計	5,487	6,882	632	13,003	△632	12,370

## (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。